

2008年1月10日

半導体用ダイボンディングフィルムの生産能力を70%増強

- SSD時代到来を見据えた積極投資を実施 -

日立化成工業株式会社（本社：東京、執行役社長：長瀬 寧次、資本金：154億円）は、約20億円を投じ、フラッシュメモリーなどのスタックド・マルチチップ・パッケージ（スタックドMCP）^{*1}向けに今後大幅な需要の拡大が見込まれる「ダイボンディングフィルム」の生産能力を段階的に増やし、2008年5月までに現状比約70%の増強を行います。

音楽携帯端末、メモリーカードや今後需要拡大が見込まれるソリッドステートドライブ(SSD)^{*2}などのエレクトロニクス関連機器の高機能化・高容量化に伴い、半導体デバイスにおいてはロジック系の更なる高速化及びメモリー系の大容量化が強く求められており、半導体パッケージの構造においては、実装面積をより小さく、より高密度にできるスタックドMCPの採用が急速に進んでいます。

当社は、これらの半導体チップの高積層化に伴う市場のニーズに対応するため、熱サイクル性や耐湿性、耐はんだリフロー性など半導体パッケージの信頼性を向上させることができるダイボンディングフィルムを生産し顧客に供給しているほか、顧客の半導体パッケージ製造工程短縮のためダイシングテープとダイボンディングフィルムの機能を併せ持つダイシング・ダイボンディング一体型フィルムを供給するなど、幅広い製品を提供し売上を拡大してきました。

今般当社は、五井事業所（千葉県市原市）にて設備投資を行い、2008年5月までに既存の製造ラインを段階的に増強し、生産能力を現在の約70%増に当たる年間約200万㎡に拡大します。

さらに、今般の生産能力増強に伴い、新製品の投入も積極的に行います。半導体製造メーカーにおいて製造プロセスの合理化が図れる「電極取り出し用金ワイヤ埋め込みタイプ」のダイボンディングフィルムの製造強化、センサー用半導体パッケージの製造プロセスでの需要が見込まれている「感光性パターン形成タイプ」のダイボンディングフィルムの販売促進、及び半導体のチップ厚み50μm以下で適用が検討されている次世代の半導体製造方式であるレーザー光を用いたダイシング方式において使用可能なダイボンディングフィルム「レーザーダイシングタイプ」の開発の推進等、今後も幅広いラインアップの製品を展開し、顧客ニーズに対応してまいります。

以上

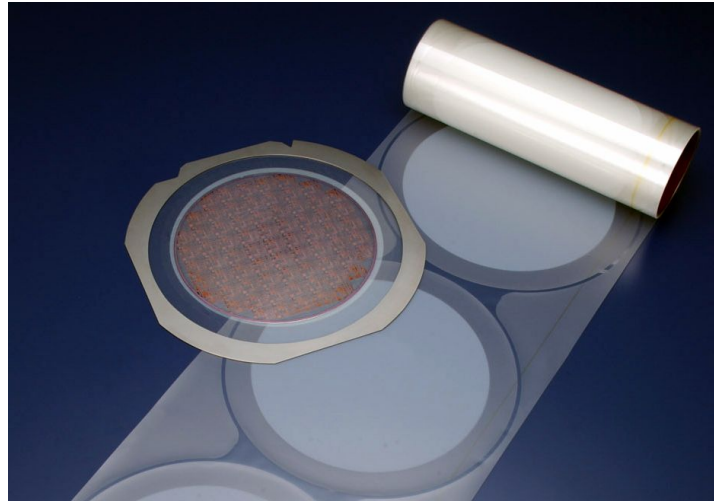
*1 スタックドMCP:1つのパッケージ内に複数の薄型化した半導体チップを積層(スタック)したものである。これまでの4段、5段に加え、最近では8段以上とさらに高積層化が進められており、これらの接続には、ウエハバックグラインド工程後にそのままウエハ裏面に貼り付けが可能で、ダイシング後の実装が容易なダイボンディングフィルムの需要が急速に高まっています。

*2 ソリッドステートドライブ(SSD):磁気ディスクの代わりに半導体メモリーにデータを記録するストレージ装置。ハードディスク(HDD)の代替品として扱われ、今後は、パソコンへの搭載や、カーナビ、テレビなどのデジタル家電への組み込みが期待されます。

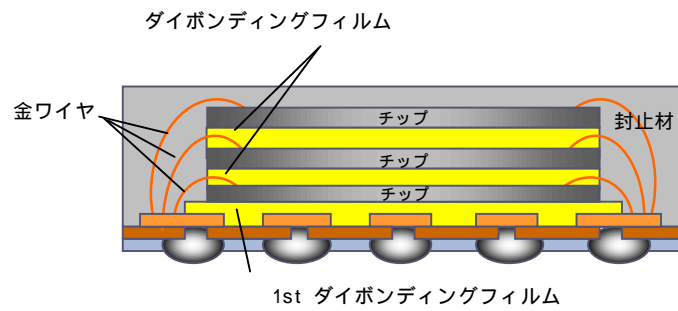
(報道関係お問い合わせ先)

日立化成工業株式会社 経営戦略室 広報担当 長谷川・河野 TEL 03-5381-2375

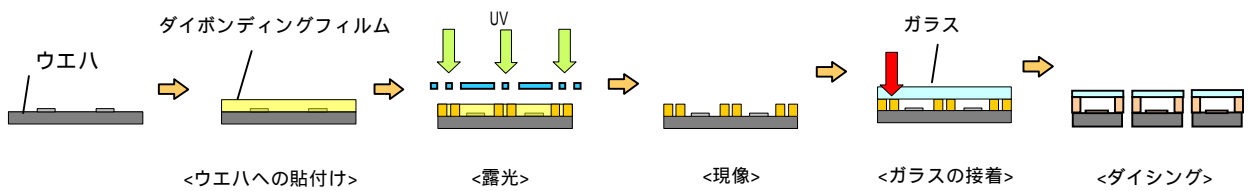
<ご参考>



【ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム】



【電極取り出し用金ワイヤ埋め込みタイプのダイボンディングフィルム使用例】



【感光性パターン形成タイプのダイボンディングフィルム使用例】